

출력 일자: 2003/9/1

발송번호 : 9-5-2003-034371388
발송일자 : 2003.08.30
제출기일 : 2003.10.30

수신 : 서울 강남구 역삼1동 824-19 동경빌딩(특
허법인 코리아나)
특허법인코리아나[박해선] 귀하
135-934

특허청 의견제출통지서

NEC01P-1228

意見提出通知書

출원인 명칭 엔이씨 일렉트로닉스 코퍼레이션 (출원인코드: 520020416681)
주소 일본 211-8668 가나가와켄 가와사끼시 나카하라구 시모누마베 1753

대리인 명칭 특허법인코리아나
주소 서울 강남구 역삼1동 824-19 동경빌딩(특허법인 코리아나)
지정된변리사 박해선 외 2명

출원번호 10-2001-0052507

발명의 명칭 수지로 캡슐화된 BGA형 반도체 장치 및 그의 제조방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출 기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

1. 이 출원은 아래에 지적한 바와 같이 특허법 제45조의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

2. 이 출원의 특허청구범위 제1-6항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

1. 특허법 제45조

본원발명 청구항 제1-6항의 발명은 유기절연기판을 실장기판으로 하는 반도체패키지에 관한 발명이고, 청구항 제7-15항의 기술은 금속평판을 가공하여 반도체칩의 실장기판으로 이용하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지에 관한 발명이므로 본원은 1특허출원의 요건을 충족하지 못합니다.(이 출원은 특허법 제52조에 의하여 분할 출원할 수 있습니다.)

2. 특허법 제29조 제2항

본원발명 청구항 제1-6항의 요지는 경박단소화된 반도체패키지를 위해 절연막에 스루홀을 형성하여 제1, 2패턴을 경유해서 연결하는 실장기판에 반도체칩을 탑재하는 기술의 제공에 있습니다.

그러나 이는 이미 종래의 기술로 일본공개특허공보 평10-4151(1998.1.6.)에서 반도체칩을 비아를 통해 연결된 기판의 상하부에 패턴에 전기접속하는 기술과 일본공개특허공보 평11-54646(1999.2.26.)에서 상하부에 패턴을 구비하는 비아홀이 형성된 기판에 반도체칩을 탑재하는 기술의 결합으로부터 본원의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 수준에서 용이하게 발명할 수 있습니다.

[참 부]

첨부 1 일본공개특허공보 평10-004151호(1998.01.06) 1부

첨부2 일본공개특허공보 평11-054646호(1999.02.26) 1부 끝.



출력 일자: 2003/9/1

2003.08.30

특허청

심사4국

반도체2심사담당관실

심사관 유한철



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5743 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터